

Systemy klejenia okładzin ceramicznych i kamiennych

Przewodnik

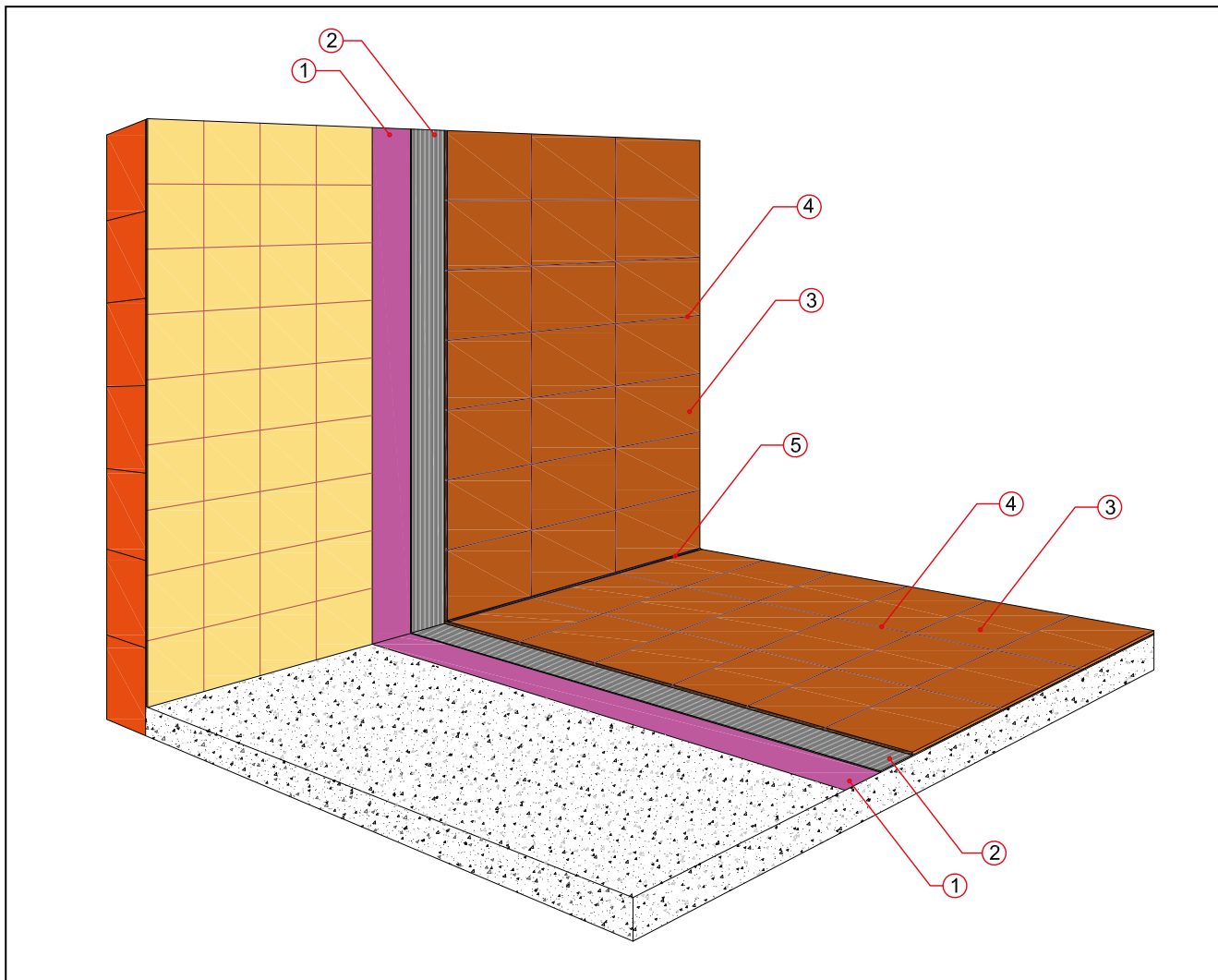


A brand of

BASF

We create chemistry

3. Płytki na podłożu nienasiąkliwym



Nr	Elementy systemu	Produkt PCI	Opis produktu
1	Grunt	PCI Gisoground 404	Grunt dyspersyjny do podłoży chłonnych i niechłonnych
2	Klej do płytek	PCI Pericol Extra	Cementowy klej o podwyższonych parametrach
3	Płytki		
4	Fuga	PCI Nanofug Premium PCI Pericolor Flex	Elastyczna fuga cementowa Elastyczna fuga cementowa
5	Uszczelniacz	PCI Silcofug E	1-składnikowy uszczelniacz silikonowy

Opis obiektu - warunki eksploatacji - obciążenia

Okładziny płytkowe ceramiczne na podłożach nienasiąkliwych występują na ścianach i posadzkach we wnętrzach obiektów o różnej funkcji: mieszkalnych, biurowych, handlowych, wystawowych, użyteczności publicznej itp. Obiekty te zostały wyremontowane z jednoczesną zmianą lub zachowaniem ich pierwotnej funkcji. Warunki pracy takich okładzin (w tym obciążenia i ewentualne dylatacje) wykazują podobieństwo do opisanych już w rozdziale „01. Płytki na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2). Poniższe zalecenia odnoszą się do przykładowego rozwiązania, prezentowanego na schemacie powyżej.

Podłoże

Podłożem jest zazwyczaj stara okładzina płytkowa - ścienna lub posadzkowa. Na ścianach może też występować dawna powłoka malarska (np. tzw. lamperia olejna), a na posadzkach - lastrico w formie płytek lub wylewane. Wymaga się, aby podłoża te były przede wszystkim nośne, tzn. wszystkie warstwy, tworzące podłoże na tyle dobrze przylegały do siebie, aby pod wpływem dodatkowych obciążeń, pochodzących od nowej okładziny nie doszło nigdzie do rozerwania zespolenia sąsiadujących

warstw. Dotyczy to szczególnie starych okładzin i powłok malarskich na ścianach, pod którymi często znajdują się zbyt słabe tynki. Ponadto podłoże musi być czyste, pozbawione rys, wykruszeń i wystarczająco równe. Posadzki lastrico często wymagają usunięcia nagromadzonej w nich przez lata pasty podłóg, której obecność utrudnia przyczepność nowych warstw. W razie konieczności szybkiego wyrównania, można tego dokonać na posadzkach masą cementową poziomującą **PCI Pericem 515**, na ścianach natomiast cementową szpachlówką **PCI Pericret**. Produkty te umożliwiają kontynuację robót już po kilku dniach, a nawet kilku godzinach. W podłożu winny być widoczne wszelkie wynikające z projektu dylatacje. Bliższe informacje o dylatacjach patrz podrozdział „Podłoże” w rozdziale „01. Płytki na podłożu nieodkształcalnym” (strona 2).

Wykonawstwo

A. GRUNTOWANIE

Do gruntowania podłoża niechłonnych pod okładzinę płytkową (lub ewentualne warstwy wyrównawcze) stosuje się środek **PCI Gisoground 404**, w rozcieńczeniu wodą, wynikającym z jego karty technicznej.

B. WYKLEJENIE PŁYTEK

Do mocowania okładzin należy stosować cementowy klej o podwyższonych parametrach (C2T wg PN-EN 12004) - **PCI Pericol Extra**. Na posadzkach, które będą poddawane znacznym obciążeniom mechanicznym, wynikającym np. z intensywnego ruchu wózków ręcznych lub pochodzącym od ciężkich mebli, regałów sklepowych itp., zaleca się przyklejanie płytek metodą kombinowaną.

C. SPOINOWANIE PŁYTEK

Spoinowanie najlepiej wykonać elastyczną cementową fugą: **PCI Nanofug Premium** lub **PCI Pericolor Flex**. Szerokość fug zależy od rozmiaru płytek i winna być określona przez projektanta w projekcie rozmieszczenia elementów okładziny.

W dylatacjach obwodowych posadzki przy ścianach i słupach, a także w ewentualnych dylatacjach ścian, należy wypełnić spoiny uszczelniaczem silikonowym **PCI Silcofug E**. W ewentualnych dylatacjach w powierzchni posadzki zaleca się wypełnienie uszczelniaczem poliuretanowym **PCI Elritan 140**, gruntując go od strony płytek środkiem **PCI Elastoprimer 145**. Pod uszczelniaczem umieścić wałek dylatacyjny, np. **DIN Polyband 08**.

Uwagi

Wskazane rozwiązanie należy traktować jako przykładowe. Każdorazowo należy je adaptować do konkretnej konstrukcji i warunków eksploatacyjnych, opierając się na zasadach wiedzy budowlanej. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z regionalnym Doradcą Technicznym PCI.